

SVERIGE

(12) **PATENTSKRIFT**(13) **C2** (11) **522 867**

(19) SE

(51) Internationell klass 7
H01L 7/02, 1/18
**PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET**

(45) Patent meddelat 2004-03-16

(41) Ansökan allmänt tillgänglig 2001-12-21

(22) Patentansökan inkom 2001-06-19

(24) Löpdag 2001-06-19

(62) Stamansökans nummer

(86) Internationell ingivningsdag

(86) Ingivningsdag för ansökan
om europeisk patent

(83) Deposition av mikroorganism

(21) Patentansöknings-
nummer 0102167-4

Ansökan inkommen som:

☒ svensk patentansökan
fullföljd internationell patentansökan
med nummer

☐ omvandlad europeisk patentansökan
med nummer

(30) Prioritetsuppgifter

2000-06-20 JP 12/184046

(73) PATENTHAVARE Murata Mfg Co Ltd, 26-10 Tenjin 2-chome Kyoto-fu 226
Nagaokakyo-shi JP(72) UPPFINNARE Toshifumi Oida, Nagaokakyo-shi JP, Norio Nakkajima,
Nagaokakyo-shi JP, Eigoro Ina, Nagaokakyo-shi JP, Takahiro
Watanabe, Nagaokakyo-shi JP

(74) OMBUD Zacco Sweden AB (publ)

(54) BENÄMNING RF-modul

(56) ANFÖRDA PUBLIKATIONER:

EP A2 0 996 155 (H01L 23/36), US A 5 450 046 (H03H 11/02)

(57) SAMMANDRAG:

RF-modulen är försedd med ett flerskiktssubstrat. En IC-bas-bandkrets, en IC-minneskrets, en kvartsoscillator och ytmonterade komponenter är monterade på flerskiktssubstratets översida. En metallkåpa är även fästad på flerskiktssubstratets översida. Ett hålrum är utformat i flerskiktssubstratets undersida, väsentligen i mitten av detsamma. En första RF-IC-krets och en andra RF-IC-krets är inbäddade i hålrummet. Ledningsmönster 32 för förbindelse mellan IC-basbandkretsen och IC-minneskretsen, genomgående hål, passiva RF-komponenter, och avskärmande jordelektrodmönster är utformade inne i flerskiktssubstratet.

